

产品数据表

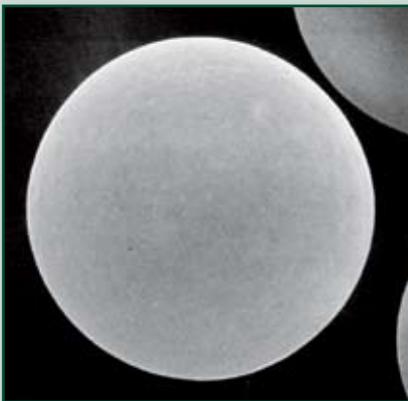
精密焊球

特点

- 直径精确
- 表面闪亮
- 球形完美
- 金属纯度高

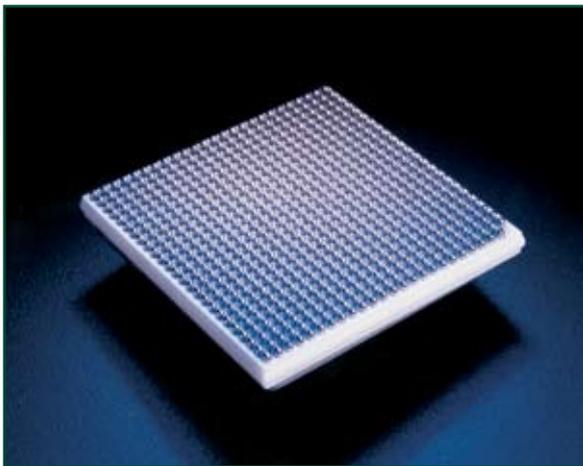
简介

钢泰公司生产直径精确、表面闪亮、球形完美的焊球。我们的焊球产品由专门车间制造并以统计流程控制(SPC)支持。



SEM 显微相片 350X

所有焊球均用各种高纯度金属制造，构成精确的合金成分。焊球成型后用自动化高产率流程按照大小分类，表面光洁。

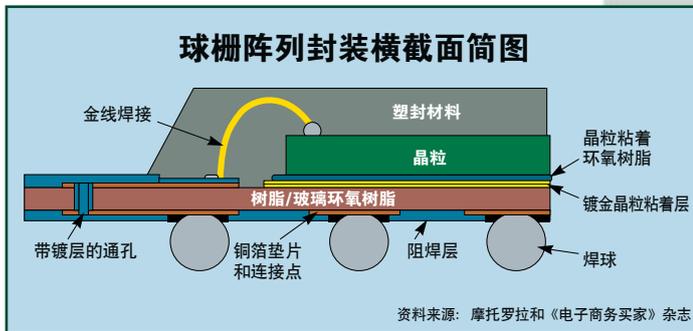


XCBGA 照片由IBM提供

典型金属

封装最常用的合金如下表所列。若需其它合金请跟我们联系。

合金	液相°C	固相°C
63锡37铅	183 共晶合金	—
90铅10锡	302	275
95.5锡3.8银0.7铜	220	217
96.5锡3银0.5铜	220	217
95.5锡4银0.5铜	220	217



典型直径

通常要求大小范围:

300µm (.0118") 至 1270µm (.0500")

另供应其它尺寸及公差，最小可达100µm (.00394")。请咨询本公司技术人员。

允差:

0.25mm-0.35mm ±10µm (0.00039")

0.40mm-0.50mm ±15µm (0.00059")

0.55mm-0.76mm ±20µm (0.00079")

包装

根据顾客需要提供各种包装，包括40毫升、100毫升和 200毫升ESD 罐装，包含无接触式干燥剂。若顾客需要，可提供惰性氩气。

技术支持

钢泰公司国际经验丰富的工程技术人员向顾客提供深度技术协助。本公司的技术支持工程师具有将材料科学应用于电子及半导体工业中的各方面知识，可提供关于焊料特性、合金兼容性以及选用预成型焊片、焊线、焊带及焊膏的专家建议。钢泰公司的技术支持工程师对所有技术咨询都提供迅速反馈。

后续→

表格编号 98117(SC A4) R1

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
china@indium.com
中国 +86 (0)512 628 34900
新加坡 +65 6268 8678
英国 +44 (0) 1908 580400
美国 +1 315 853 4900



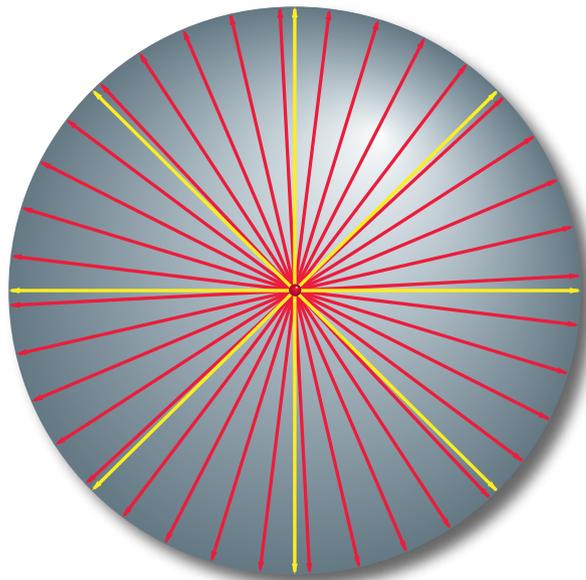
经
ISO 9001
注册

精密焊球

分析方法和实验室支持

每件产品发货时都附有标准分析证书，说明对成分的化学分析及化学纯度。其它信息选项（如球粒直径测量资料）可根据顾客要求提供。

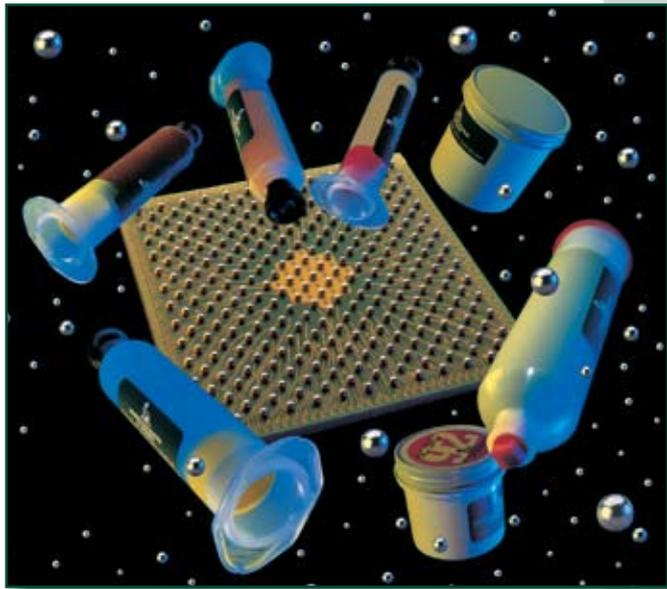
球径分布通过计算机化图像分析系统和光学对比仪进行测量。也可根据顾客需要采用其它设备来保证产品质量：



- AC/DC 火花发射分光光度计
- 光学发射摄谱仪
- 原子吸收仪
- 示差扫描热量计
- 辉光放电质谱仪
- 扫描电子显微镜
- 俄歇电子能谱仪

兼容产品

钢泰公司提供全系列芯片组装产品，包括TACFlux® 高粘度助焊剂，用于在粘着过程中保持焊球位置；专利的InTEGRATED™ 焊料预成形阵列，用于BGA植球工艺；全系列倒装芯片助焊剂；晶粒粘着粘胶剂；以及整套用于晶粒和凸点焊接的焊膏。若有需要，请跟我们联系。



钢泰公司提供支持产品。

材料安全性数据表

本产品材料安全性数据表 (MSDS) 可上网查索：
<http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>

所有资料均仅供参考。不得用作收到产品之规格。

本产品数据表仅提供一般信息，并无意也不应被视为对有关产品的性能保证或担保。所出售产品之性能应以附于包装及发票中之保证书及使用限制文字说明为准。

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
 china@indium.com
 中国 +86 (0)512 628 34900
 新加坡 +65 6268 8678
 英国 +44 (0) 1908 580400
 美国 +1 315 853 4900



经
 ISO 9001
 注册